【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成16年12月24日(2004.12.24)

【公開番号】特開2002-43496(P2002-43496A)
【公開日】平成14年2月8日(2002.2.8)
【出願番号】特願2000-220855(P2000-220855)
【国際特許分類第７版】
　ＨＯ１Ｌ　23/50
　ＨＯ１Ｌ　25/07
　ＨＯ１Ｌ　25/18
【ＦＩ】
　ＨＯ１Ｌ　23/50　　Ｍ
　ＨＯ１Ｌ　23/50　　Ｆ
　ＨＯ１Ｌ　23/50　　Ｙ
　ＨＯ１Ｌ　25/04　　Ｃ

【手続補正書】
【提出日】平成16年1月29日(2004.1.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、リードフレームを有する半導体装置に関する。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
本発明の目的は、製造工程が複雑になる虞れがないこと、または、製造コストの低減が図れるようにしたリードフレーム構成の半導体装置を提供することにある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５１】
本発明によれば、以下に列挙する効果を得ることができる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５４】
(3)
外部導出端子成形時に、任意の場所でリードフレームを折り曲げることができるので、外

部導出端子の導出位置が任意に選べることになり、適用半導体装置の範囲が広くなる。
(4)
リードフレーム自体では二次元形状なので、運搬時において積載効率が改善できる。
(5)
リードフレームの圧着に必要な設備の小型化が可能となる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５５】
【発明の効果】
本発明によれば、製造工程が複雑になる虞れがないこと、または、製造コストの低減が図れるようにしたリードフレーム構成による半導体装置を提供することが可能になる。